

Attorney Docket # 5367-83

Express Mail #EV375318422US
Patent

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of

Wilhelm STEIN et al.

Serial No.: n/a

Filed: concurrently

For: Electrical Contact for Optoelectronic
Semiconductor Chip and Method for its
Production

LETTER TRANSMITTING PRIORITY DOCUMENT

Mail Stop **Patent Application**
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

SIR:

In order to complete the claim to priority in the above-identified application under 35 U.S.C. §119, enclosed herewith is the certified documentation as follows:

Application No. **10308325.1**, filed on February 26, 2003, in Germany,

Application No. **10350707.8**, filed on October 30, 2003, in Germany, upon which
the priority claim is based.

Respectfully submitted,
COHEN, PONTANI, LIEBERMAN & PAVANE

By Thomas Langer
Thomas Langer
Reg. No. 27,264
551 Fifth Avenue, Suite 1210
New York, New York 10176
(212) 687-2770

Dated: February 26, 2004

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 103 08 325.1

Anmeldetag: 26. Februar 2003

Anmelder/Inhaber: Osram Opto Semiconductors GmbH,
93049 Regensburg/DE

Bezeichnung: Elektrischer Kontakt für optoelektronischen Halb-
leiterchip und Verfahren zu dessen Herstellung

IPC: H 01 L 33/00

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 29. Januar 2004
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hintermeier'.

Hintermeier

Elektrischer Kontakt für optoelektronischen Halbleiterchip
und Verfahren zu dessen Herstellung

Beschreibung

5

Die Erfindung betrifft einen elektrischen Kontakt für einen optoelektronischen Halbleiterchip und ein Verfahren zu dessen Herstellung.

10

Bei modernen Herstellungsverfahren für lichtemittierende Dioden (LEDs) wird häufig die lichtemittierende Struktur zunächst auf einem Aufwachssubstrat aufgewachsen, anschließend auf einen neuen Träger aufgebracht und dann das Aufwachssubstrat abgetrennt. Dieses Verfahren hat einerseits den Vorteil, daß Aufwachssubstrate, insbesondere für die Herstellung von Nitridverbindungshalbleitern geeignete Aufwachssubstrate, die vergleichsweise teuer sind, wiederverwendet werden können. Ein derartiges Bauelement ist beispielsweise aus der WO 02/19493 A1 bekannt. Dieses als Dünnschichttechnologie bezeichnete Verfahren hat weiterhin den Vorteil, daß durch das Ablösen des ursprünglichen Substrats dessen Nachteile, wie zum Beispiel eine geringe elektrische Leitfähigkeit und eine erhöhte Absorption der von dem optoelektronischen Bauelement generierten oder detektierten Strahlung, vermieden werden. Dadurch läßt sich die Effizienz von LEDs, insbesondere der Helligkeit, steigern.

15

20

25

30

35

Eine weitere Technologie zur Herstellung von hocheffizienten LEDs stellt die sogenannte Flip-Chip-Technologie dar. Ein derartiges Bauelement wird beispielsweise in der WO 01/47039 A1 offenbart. Hierin wird ein strahlungsemitterender Halbleiterchip beschrieben, der sowohl mit dem n- als auch mit dem p-Kontakt über eine gelötete Direktverbindung mit einem Trägersubstrat verbunden ist.

Sowohl bei der Dünnschichttechnologie als auch bei der Flip-Chip-Technologie ist es vorteilhaft, den Kontakt zwischen dem

Halbleiterchip und dem Trägersubstrat als einen reflektierenden Kontakt auszubilden. Damit wird ein Eindringen der von einem optoelektronischen Bauelement generierten oder detektierten Strahlung in den Kontakt vermieden und damit die Absorptionsverluste reduziert.

Ein derartiger spiegelnder elektrischer Kontakt wird beispielsweise in der EP 0 926 744 A2 offenbart. In diesem Dokument wird eine Silberschicht als geeigneter ohmscher Kontakt für eine p-Typ GaN-Halbleiter angegeben. Es wird jedoch auch auf die geringe Haftfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit von Silberschichten auf Nitridverbindungshalbleitern hingewiesen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen verbesserten elektrischen Kontakt anzugeben. Insbesondere soll sich der Kontakt durch eine hohe Reflektivität, einen guten ohmschen Kontakt zum Halbleiter, eine gute Haftung auf dem Halbleiter sowie eine gute Haftung der den Kontakt bildenden Schichten untereinander, eine gute Temperaturstabilität, eine hohe Stabilität gegen Umwelteinflüsse, sowie Lötbarkeit und Strukturierbarkeit auszeichnen. Ferner ist es Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Kontakts anzugeben.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch einen elektrischen Kontakt mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 bzw. durch Verfahren gemäß den Patentansprüchen 20, 21 oder 23 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.

Ein erfindungsgemäßer elektrischer Kontakt eines optoelektronischen Halbleiterchips enthält eine Spiegelschicht aus einem Metall oder einer Metallegierung, eine Schutzschicht, die zur Verringerung der Korrosion der Spiegelschicht dient, eine Barrierenschicht, eine Haftvermittlungsschicht und eine Lotschicht.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung werden im folgenden anhand eines Ausführungsbeispiels im Zusammenhang mit den Figuren 1 und 2 näher erläutert. Dabei zeigen

5

Figur 1 einen schematischen Querschnitt durch eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen elektrischen Kontakts und

10

Figur 2 schematisch dargestellte Zwischenstufen zu Erläuterung der Strukturierung mittels Abhebetechnik.

15

Figur 1 zeigt einen Halbleiterchip 1, auf den eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen elektrischen Kontakts aufgebracht ist. Der Halbleiterchip kann an seiner Oberfläche beispielsweise ein Material aus der Gruppe der Nitridverbindungshalbleiter aufweisen, wobei unter Nitridverbindungen Halbleiter eine Nitridverbindung von Elementen der dritten und/oder fünften Hauptgruppe, insbesondere GaN, AlGaN, InGaN, AlInGaN, AlN oder InN, verstanden wird.

20

Auf den Halbleiterchip 1 ist eine Spiegelschicht 2 aufgebracht. Die Spiegelschicht enthält ein Metall oder eine Metallegierung, vorzugsweise eines der Metalle Silber, Aluminium oder Platin. Bevorzugt ist die Spiegelschicht 2 zwischen 70 nm und 130 nm dick. Die Spiegelschicht 2 reflektiert die aus der Richtung des optoelektronischen Halbleiterchips 1 auftreffende Strahlung und verhindert dadurch die Absorption dieser Strahlung im elektrischen Kontakt. Neben dieser vorteilhaften optischen Eigenschaft stellt die Spiegelschicht auch einen ohmschen Kontakt zum Halbleiter her. Beispielsweise kann zur Herstellung eines ohmschen Kontakts auf einem InGaN-Halbleiter eine Pt/Al-Kombination verwendet werden. Auf p-GaN-Halbleitermaterial ist eine Silberschicht zur Herstellung eines ohmschen Kontaktes geeignet.

35

Weiterhin ist eine Schutzschicht 3 auf die Spiegelschicht 2 aufgebracht, um sie in weiteren Prozeßschritten vor Korrosion zu schützen. Vorzugsweise handelt es sich bei der Schutzschicht 3 um eine zwischen 5 nm und 15 nm dicke Titan- oder Platinschicht. Im Falle einer naßchemischen Strukturierung der Spiegelschicht 2 wird vorzugsweise Titan als Material für die Schutzschicht 3 verwendet, da das Ätzen von Platin technisch sehr schwierig ist.

- 10 Eine Verbesserung der Haftung der Spiegelschicht 2 auf dem Halbleiterchip 1 kann durch einen Tempersschritt erreicht werden. Beispielsweise wird eine Spiegelschicht 2 aus Silber für etwa 5 Minuten bei 300 °C getempert. Im Falle einer naßchemischen Strukturierung der Spiegelschicht 2 kann dieser Tempersschritt unmittelbar nach der Beschichtung durchgeführt werden.

- Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung der Haftung der Spiegelschicht 2 besteht darin, vor dem Aufbringen der Spiegelschicht 2 eine zwischen 0,1 nm und 0,5 nm dünne Schicht 13 aus einem elektrisch transparenten Material auf den Halbleiterchip 1 aufzubringen. Diese dünne Schicht 13 enthält vorzugsweise Pt, Pd oder Ni. Besonders vorteilhaft ist die Verwendung dieser Materialien auf einer ein Nitridverbindungs-
halbleitermaterial aufweisenden Oberfläche eines Halbleiterchips 1 und bei Verwendung einer Spiegelschicht 2, die Ag oder Al enthält.

- Auf die Schutzschicht 3 ist eine Barrierenschicht 4 aufgebracht. Vorzugsweise enthält die Barrierenschicht 4 TiW(N) und ist etwa 300 nm bis 500 nm dick. Durch eine Strukturierung der Barrierenschicht 4 mittels Abhebetechnik (lift-off-Technik), die im Folgenden noch genauer beschrieben wird, kann eine vollständige Überdeckung der Spiegelschicht 2 und der Schutzschicht 3 mit der Barrierenschicht 4 erreicht werden. Auch die Strukturierung der folgenden Schichten kann mittels dieser Abhebetechnik erfolgen. Ein Vorteil dieser Art

der Strukturierung besteht in der geringen Temperaturbelastung des Schichtsystems.

5 Auf die Barrierenschicht 4 ist eine Haftvermittlungsschicht 5 aufgebracht, die eine gute Haftung der nachfolgenden Schichten gewährleistet. Bei der Haftvermittlungsschicht 5 handelt es sich bevorzugt um eine zwischen 30 nm und 70 nm dicke Titanschicht.

10 Darauf ist vorzugsweise eine Benetzungsschicht 6 aufgebracht, die eine gleichmäßige Benetzung der Kontaktfläche mit dem Lot beim späteren Lötvorgang bewirkt. Bevorzugt ist die Benetzungsschicht 6 eine zwischen 70 nm und 130 nm dicke Platinschicht.

15 Auf der Benetzungsschicht 6 ist eine Lotschicht 8, bei der es sich entweder um ein Hartlot, wie beispielsweise AuSn oder ein Weichlot wie zum Beispiel Sn handeln kann, aufgebracht. Die Lotschicht 8 ist beispielsweise mittels PVD-Technik oder
20 mittels galvanischer Abscheidung aufgebracht. Eine Strukturierung der Lotschicht 8 ist mittels der zuvor beschriebenen Abhebetechnik oder mittels einer naßchemischen Strukturierung möglich.

25 Die Lotschicht 8 kann optional mit einer Goldschicht 9 abgedeckt werden, die vorzugsweise zwischen 30 nm und 70 nm dick ist.

Vorteilhaft ist zwischen der Benetzungsschicht 6 und der Lotschicht 8 eine Goldschicht 7 eingefügt, welche das darunterliegende Schichtsystem vor dem Aufbringen der Lotschicht 8 vor Korrosion schützt. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn vor dem Aufbringen der Lotschicht eine Entfernung einer zur Strukturierung des bis dahin erzeugten Schichtsystems
35 aufgetragenen Maskenschicht erfolgt. Die bevorzugte Dicke einer solchen Goldschicht 7 beträgt bei Verwendung eines Sn-Lots etwa 70-130 nm, bei Verwendung eines AuSn-Lots etwa 400

nm bis 800 nm. Die Funktion der Benetzungsschicht 6 bleibt trotz dieser Zwischenschicht erhalten, da die Goldschicht 7 beim späteren Lötvorgang schmilzt.

5 Beim Lötvorgang ist es möglich, aber unerwünscht, dass das Lot bis an die Seitenflanken des Halbleiterchips aufsteigt. Um hierbei einen Kurzschluß des Lots mit den an den Seitenflanken des Halbleiterchips endenden Halbleiterschichten zu verhindern, können die Seitenflanken mit einer Passivierung
10 11, beispielsweise aus Siliziumdioxid oder Siliziumnitrid, versehen werden.

Zur Strukturierung eines erfindungsgemäßen elektrischen Kontaktes sind beispielsweise bekannte Verfahren zur naßchemischen Strukturierung, die hier nicht näher erläutert werden
15 sollen, geeignet. Vorzugsweise wird im Rahmen der Erfindung die sogenannte Abhebeteknik (lift-off-Verfahren) angewandt.

Die Verfahrensschritte bei der Abhebeteknik werden im Folgenden beispielhaft anhand der Strukturierung der Spiegelschicht 2 in Zusammenhang mit den Figuren 2a bis 2e näher erläutert.
20

Wie in Figur 2a dargestellt, wird auf den Halbleiterchip 1
25 zunächst eine Maskenschicht 10 aus einem Photolack aufgebracht.

Mittels geeigneter Belichtung, Entwicklung und Ätzung wird in der Maskenschicht 10 ein Fenster erzeugt, das wie in Figur 2b
30 dargestellt einen starken Unterschnitt aufweist. Der Unterschnitt kann beispielsweise durch Unterätzung mit einem geeigneten Ätzmittel gebildet werden. Die Maskenschicht weist dadurch an der dem Halbleiterchip abgewandten Seite einen schmalen Querschnitt auf als an der Oberfläche des Halbleiterchips.
35 Vorzugsweise schließen die dem Fenster zugewandten Flanken der Maskenschicht mit der Oberfläche des Halbleiterchips 1 einen Winkel von weniger als 75° ein. Da die Bedin-

gungen zur Erzeugung eines solchen Fensters dem Fachmann bekannt sind, werden sie an dieser Stelle nicht näher erläutert.

5 Anschließend wird die Spiegelschicht 2 durch eine gerichtete Beschichtungstechnik, beispielsweise durch Aufdampfen, auf den Halbleiterchip aufgebracht. Die Abscheidung der Spiegelschicht 2 erfolgt im wesentlichen nur auf den in Aufdampf-
10 richtung 12 nicht von der Maskenschicht 10 abgeschatteten Bereich des Halbleiterchips 1, während die unter dem Unterschnitt des Fensters liegenden Bereiche des Halbleiterchips 1 abgeschattet sind und wie in Fig. 2c dargestellt nicht von der Spiegelschicht 2 bedeckt werden. Auf die gleiche Weise können im folgenden weitere Schichten, beispielsweise eine
15 Schutzschicht 3 für die Spiegelschicht 2, auf den Halbleiterchip 1 aufgebracht werden (nicht dargestellt).

Im nachfolgenden Prozeßschritt wird, wie in Figur 2d dargestellt ist, eine weitere Schicht, bei der es sich beispielsweise um eine Barrierenschicht 4 handeln kann, durch ein ungerichtetes Beschichtungsverfahren, zum Beispiel mittels
20 Sputtern, auf den Halbleiterchip 1 aufgebracht. Durch die Anwendung eines ungerichteten Beschichtungsverfahrens werden auch die unter dem Unterschnitt des Fensters liegenden Bereiche des Halbleiterchips 1 mit der aufgebrachten Schicht be-
25 deckt und somit eine vollständige Überdeckung der vorher aufgebrachten Schicht oder Schichten, beispielsweise der Spiegelschicht 2, erreicht.

30 Nach dem Ablösen der Maskenschicht 10 ist der Halbleiterchip 1, wie in Figur 2e gezeigt, mit einer strukturierten Schicht, beispielsweise der Spiegelschicht 2, und einer weiteren, diese Schicht überdeckenden Schicht, beispielsweise der Barrierenschicht 4, bedeckt.

35

Allgemein ist im Rahmen der Erfindung unter einer Abhebetechnik (lift-off-Verfahren) das Aufbringen bzw. Ausbilden einer

Maskenschicht, das Aufbringen einer oder mehrerer Schichten und ein nachfolgendes Ablösen der Maskenschicht zu verstehen. Vorzugsweise wird die Maskenschicht mit einem Unterschnitt versehen, eine erste Schicht gerichtet abgeschieden, und eine
5 zweite Schicht zur vollständigen Überdeckung der ersten Schicht ungerichtet abgeschieden, wobei unter einer vollständigen Überdeckung eine Bedeckung der Oberfläche und der Seitenflanken verstanden wird.

- 10 Ein derartiger Kontakt ist insbesondere für die Verwendung in der Flip-Chip-Technologie und der Dünnfilm-Technologie geeignet. Unter einem Dünnfilm-Halbleiterkörper ist im Rahmen der Erfindung ein epitaktisch auf einem Epitaxiesubstrat gewachsener Halbleiterkörper zu verstehen, von dem das Epitaxiesubstrat abgelöst wurde.
15

- Die Erläuterung der Erfindung anhand des Ausführungsbeispiels ist selbstverständlich nicht als Einschränkung der Erfindung zu sehen. Vielmehr können die in der Beschreibung, in den
20 Zeichnungen sowie in den Ansprüchen offenbarten Merkmale sowohl einzeln als auch in Kombination miteinander für die Verwirklichung der Erfindung wesentlich sein.

Patentansprüche

1. Elektrischer Kontakt eines optoelektronischen Halbleiterchips (1),
5 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a ß
 er
 - eine Spiegelschicht (2) aus einem Metall oder einer Metallegierung,
 - eine Schutzschicht (3) zur Verringerung der Korrosion
10 der Spiegelschicht (2),
 - eine Barrierenschicht (4),
 - eine Haftvermittlungsschicht (5), und
 - eine Lotschicht (8)
 enthält.
15
2. Elektrischer Kontakt nach Anspruch 1,
 der zwischen der Haftvermittlungsschicht (5) und der Lotschicht (8) eine Benetzungsschicht (6) enthält.
- 20 3. Elektrischer Kontakt nach Anspruch 1 oder 2,
 der auf eine ein Nitridverbindungshalbleitermaterial aufweisende Oberfläche eines Halbleiterchips (1) aufgebracht ist.
- 25 4. Elektrischer Kontakt nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
 bei dem die Spiegelschicht (2) Silber, Aluminium oder Platin enthält.
- 30 5. Elektrischer Kontakt nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 bei dem die Spiegelschicht (2) zwischen 70 nm und 130 nm dick ist.
- 35 6. Elektrischer Kontakt nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 bei dem zur Verbesserung der Haftung der Spiegelschicht (2) eine zwischen 0,1 und 0,5 nm dünne

Schicht (13) aus einem elektrisch leitfähigen Material zwischen dem Halbleiterchip (1) und der Spiegelschicht (2) enthalten ist.

- 5 7. Elektrischer Kontakt nach Anspruch 6,
bei dem die Oberfläche des Halbleiterchips (1) ein Nitrid-
verbindungshalbleitermaterial aufweist, die Spiegel-
schicht (2) Al oder Ag enthält, und die dünne Schicht (13)
Pt, Pd oder Ni enthält.
- 10 8. Elektrischer Kontakt nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
bei dem die Schutzschicht (3) Titan oder Platin enthält.
- 15 9. Elektrischer Kontakt nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
bei dem die Schutzschicht (3) zwischen 5 nm und 15 nm dick
ist.
- 20 10. Elektrischer Kontakt nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
bei dem die Barrierenschicht (4) die Spiegelschicht (2)
und die Schutzschicht (3) vollständig überdeckt.
- 25 11. Elektrischer Kontakt nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
bei dem die Barrierenschicht (4) TiW(N) enthält.
- 30 12. Elektrischer Kontakt nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
bei dem die Barrierenschicht zwischen 300 nm und 500 nm
dick ist.
- 35 13. Elektrischer Kontakt nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
bei dem die Haftvermittlungsschicht (5) Titan enthält.

14. Elektrischer Kontakt nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei dem die Haftvermittlungsschicht (5) zwischen 30 nm und 70 nm dick ist.

5

15. Elektrischer Kontakt nach einem der Ansprüche 2 bis 14,
bei dem die Benetzungsschicht (6) Platin enthält.

10

16. Elektrischer Kontakt nach einem der Ansprüche 2 bis 15,
bei dem die Benetzungsschicht (6) zwischen 70 nm und 130 nm dick ist.

15

17. Elektrischer Kontakt nach einem der Ansprüche 2 bis 16,
bei dem eine Goldschicht (7) auf die Benetzungsschicht (6) aufgebracht ist.

20

18. Elektrischer Kontakt nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei dem eine Goldschicht (9) auf die Lotschicht (8) aufgebracht ist.

25

19. Elektrischer Kontakt nach Anspruch 18,
bei dem die auf die Lotschicht (8) aufgebrachte Goldschicht (9) etwa 30 nm bis 70 nm dick ist.

30

20. Verfahren Herstellung eines elektrischen Kontakts nach einem der Ansprüche 1 bis 19,
bei dem die Spiegelschicht (2) aus Silber besteht und zur Verbesserung der Haftung bei etwa 300°C getempert wird.

35

21. Verfahren zur Herstellung eines elektrischen Kontakts nach einem der Ansprüche 1 bis 19,
bei dem der Kontakt mittels Abhebetechnik strukturiert wird.

22. Verfahren nach Anspruch 21,
bei dem eine für die Abhebetechnik auf den Halbleiter-

chip (1) aufgebrachte Maskenschicht (10) mit einem Unterschnitt versehen wird, die Spiegelschicht (2) gerichtet aufgedampft wird und die Barrierenschicht (4) mit einer ungerichteten, überdeckenden Beschichtungsmethode so aufgebracht wird, daß die Barrierenschicht (4) die darunterliegenden Schichten vollständig überdeckt.

23. Verfahren zur Herstellung eines elektrischen Kontakts nach einem der Ansprüche 6 bis 19,
bei dem zur Verbesserung der Haftung der Spiegelschicht (2) eine zwischen 0,1 und 0,5 nm dünne Schicht (13) aus einem elektrisch leitfähigen Material vor dem Aufbringen der Spiegelschicht (2) auf den Halbleiterchip (1) aufgebracht wird.

15

24. Verfahren nach Anspruch 23,
bei dem die Oberfläche des Halbleiterchips (1) ein Nitridverbindungshalbleitermaterial aufweist, die Spiegelschicht (2) Al oder Ag enthält, und die dünne Schicht (13) Pt, Pd oder Ni enthält.

20

Zusammenfassung

Elektrischer Kontakt für optoelektronischen Halbleiterchip
und Verfahren zu dessen Herstellung

5

Die Erfindung beschreibt einen elektrischen Kontakt für ein
optoelektronisches Bauelement, der eine Spiegelschicht (2)
aus einem Metall oder einer Metallegierung, eine Schutz-
schicht (3), die zur Verringerung der Korrosion der Spiegel-
schicht (2) dient, eine Barrierenschicht (4), eine Haftver-
mittlungsschicht (5), eine Benetzungsschicht (6) und eine
Lotschicht (8) enthält, sowie vorteilhafte Verfahrensschritte
zur Herstellung eines solchen Kontakts. Ein derartiger Kon-
takt zeichnet sich durch eine hohe Reflektivität, einen guten
ohmschen Kontakt zum Halbleiter, eine gute Haftung auf dem
Halbleiter sowie eine gute Haftung der den Kontakt bildenden
Schichten untereinander, eine gute Temperaturstabilität, eine
hohe Stabilität gegen Umwelteinflüsse, sowie Lötbarkeit und
Strukturierbarkeit aus.

20

Figur 1

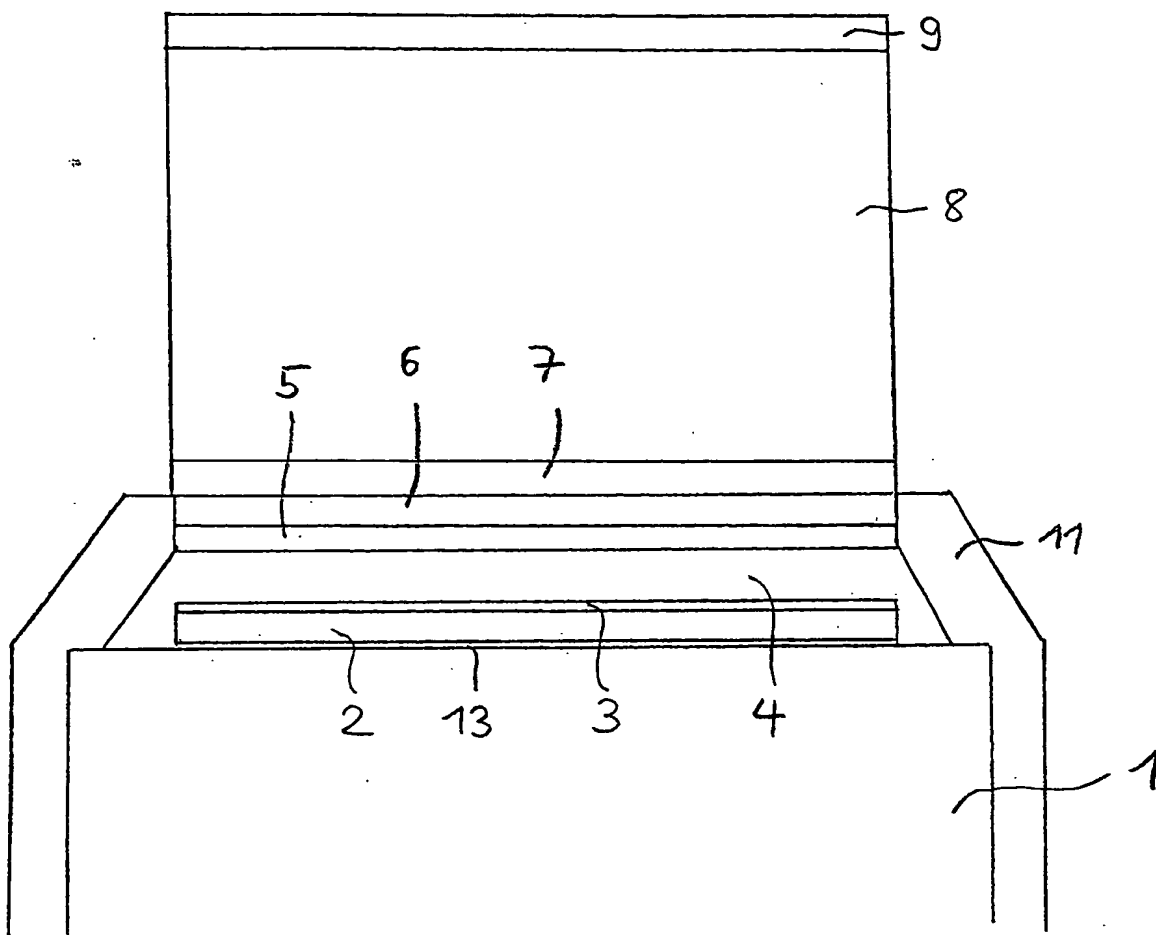


Fig. 1

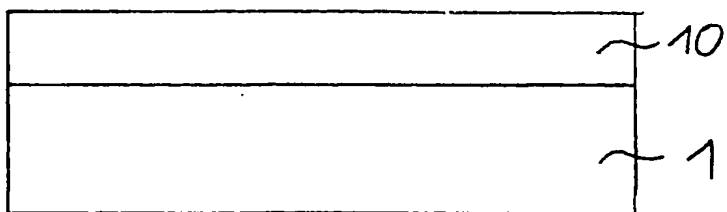


Fig. 2a

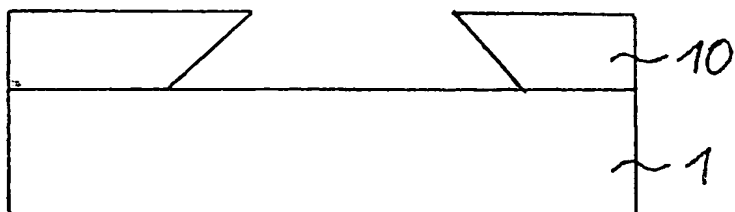


Fig. 2b

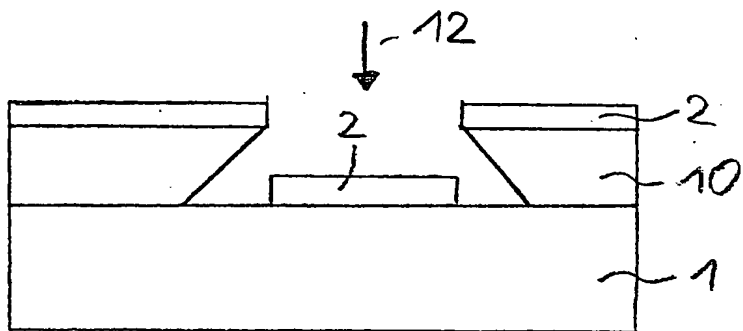


Fig. 2c

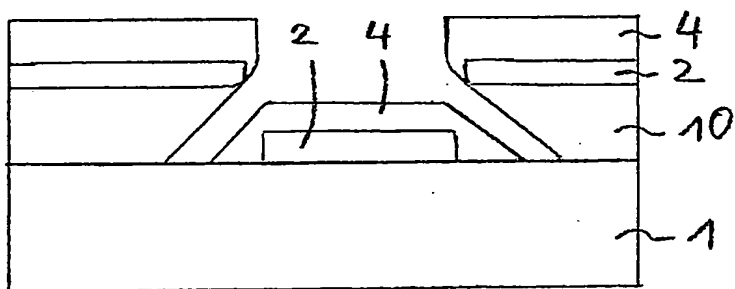


Fig. 2d

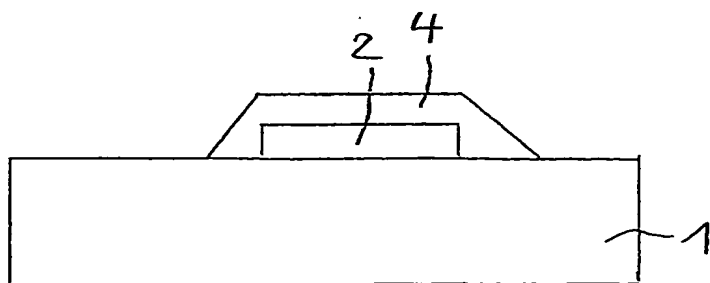


Fig. 2e